
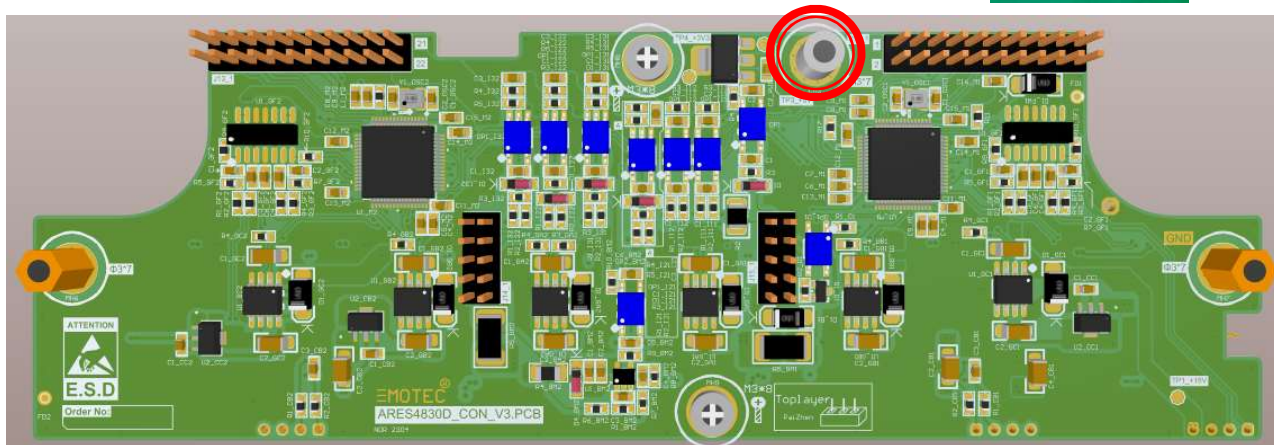


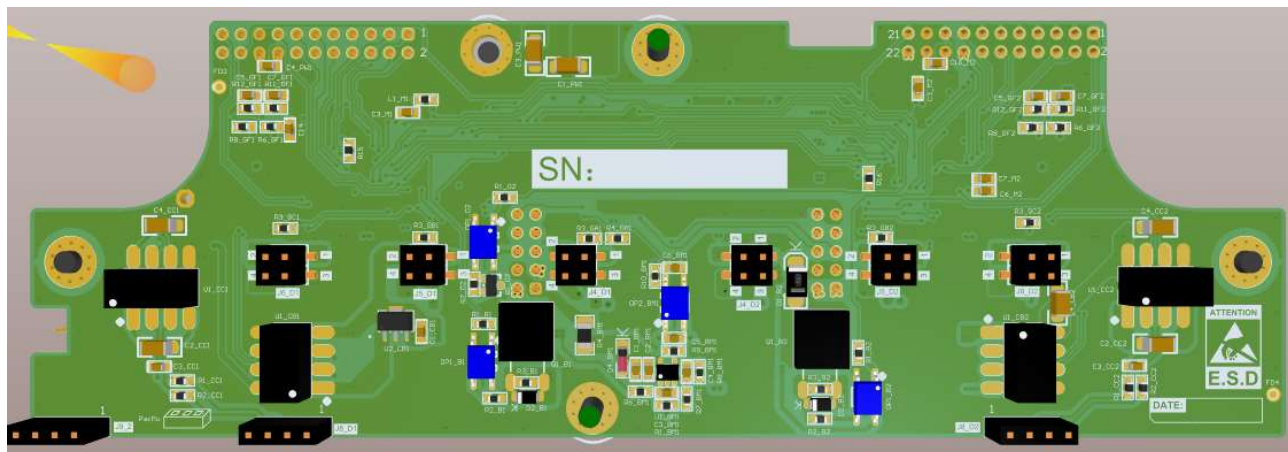
PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES4830D_CON_V3	焊接	QM0332023071002	V3	1/1	20230710

1) CON 板顶层贴片螺母焊接要求:

- a) LH2 位置焊接 SMTS03070CTJ(M3*7 带螺纹支撑柱) 
- b) 贴片螺母要求落到底焊接, 保证焊接后螺母垂直于 PCB;
- c) 贴片螺母的焊盘圆周上的过孔注满锡, 焊锡与圆柱体形成锥面 (见右图);
- d) 贴片螺母的顶端不能有沾锡



2) 与 POW 板 (功率板) 信号传递, CON 板底层上的连接件均为排母



- 3) 有端口插件焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 4) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 5) 测试点及 MARK 点, 严禁沾锡
- 6) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 7) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 8) 手工操作要做防静电处理;
- 9) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 10) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	